

# 如何提高仪器的测试准确度?

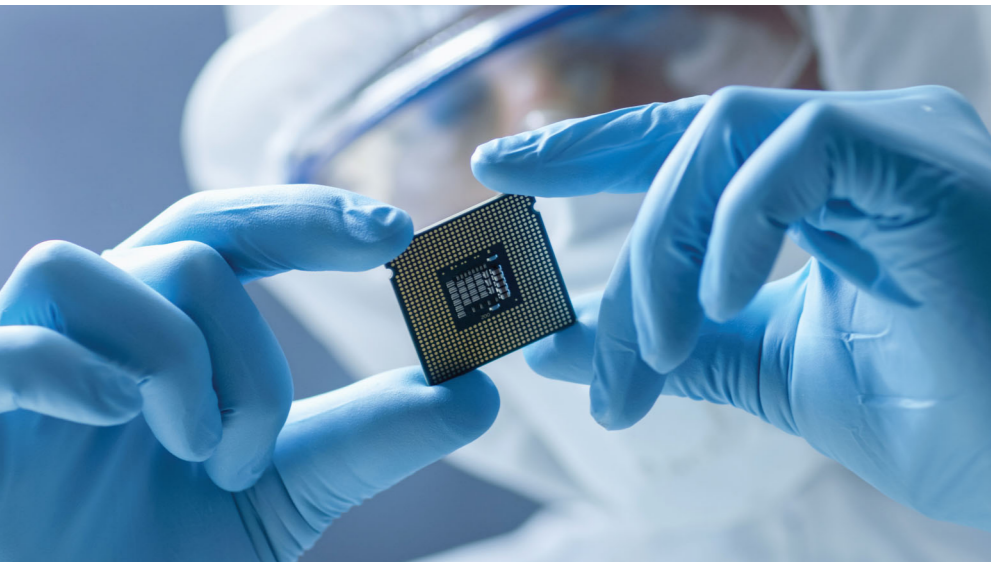
## ERNI与某集成电路测试设备领先制造商的合作

作为半导体测试设备的主要原始设备制造商，我们客户的核心竞争力在于集成电路（IC）测试设备的研究、开发和创新。他们最先进的专利技术使芯片制造商能够通过封装的半导体芯片进行自动检测，准确地筛选出半导体芯片中的缺陷和故障产品，以确保运往市场的产品的质量。

自2008年成立以来，该客户陆续在中国大陆、香港、台湾、日本、新加坡等地拓展业务，并在深圳证券交易所上市。

半导体芯片极大地影响了电子工业，并彻底改变了我们的生活。从家庭应用到诸如手机、平板电脑、笔记本电脑和电视等设备，半导体芯片改变了消费者的工作和娱乐方式！

**由于在半导体制造过程中不可能达到100%的成品率，所以对芯片的检测是必要的，并且直接影响到最终的芯片成本，因为即使是微小的缺陷也可能导致产品失败。**



## 客户应用: IC测试设备

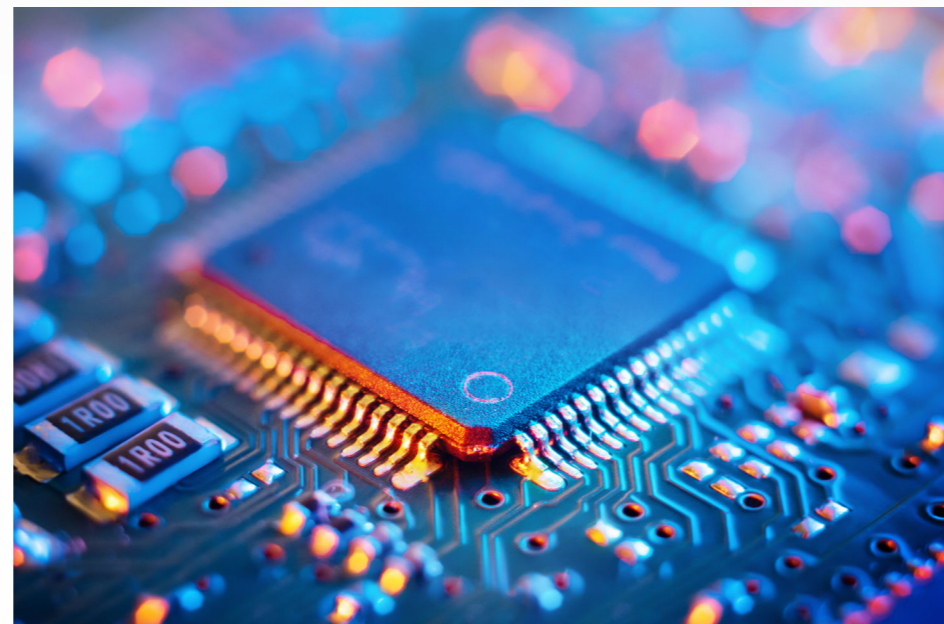
半导体芯片测试是使用测试系统和测试处理器结合自动化测试设备（ATE）进行的。

单个芯片被封装后，都要通过封装测试，也称为最终测试。

测试处理程序自动将每个芯片移动到 ATE 终端，以检查在封装过程中是否有芯片受损，然后测试测量其使用的预期性能。这个看似简单、每一步都自动化的过程很大程度上依赖于应用中的电子元件来确保测试结果的准确性

### 挑战

由于印刷电路板之间接触不良，我们的客户在使用低端连接器时难以保证数据的准确性。连接器的端子结构设计、低振动耐受性等原因导致在复杂的应用环境中信号丢失。

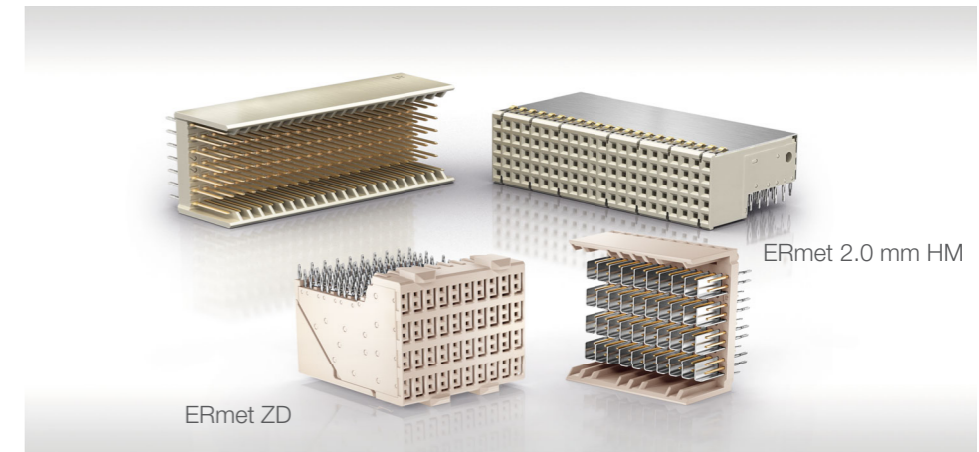


ERNI在仪器行业一直占有一席之地，我们丰富的经验和知识储备使我们比其他制造商更具竞争优势。我们的客户将ERNI视为全球高质量电子连接器的创新领导者和供应商，这绝非偶然。

## 解决方案

ERNI 的 ERmet 2.0 mm 硬公制 和 ERmet ZD 连接器符合国际工业连接器标准 IEC 61076-4-10，被广泛应用于电信和数据通信行业的高速应用。作为 CompactPCI®Express 和 PXI Express 的互连系统，该连接器系统也获得了广泛的接受和普及。

ERmet 2.0 mm 硬公制连接器可以支持各种 PCB 布局，包括子卡、扩展卡、背板和板对板应用。这些母连接器的信号触点具有双杆叶片设计，为高信号性能提供均衡的信号路径长度。



其他主要特点:

- 可用的触点阵列包括信号、高功率、高频和同轴电路设计的通用性
- 可选的针数和位置
- 编码键

ERmet ZD高速连接器允许 20 或 25 Gbit /s 的数据速率，具有出色的信号完整性。坚固的设计确保了在复杂的应用中具有高抗振动和耐热性。ERmet ZD 连接器满足高速、低压差分信号的电气性能要求。网格布局还使这些高速连接器能够与 ERmet 2.0 mm 硬公制集成。

如需更多信息，请访问 [www.erni.cn/ermet](http://www.erni.cn/ermet) 和 [www.erni.cn/ermetzd](http://www.erni.cn/ermetzd)

出于保密原因，我们无法在本成功案例中透露客户的具体信息。如果您想了解 ERNI可提供哪些连接解决方案，欢迎通过以下方式联系我们。邮件：[info.ecn@erni.com](mailto:info.ecn@erni.com)